

深圳市龙图光罩股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	中信资管、国泰基金、前海开源基金、深高新投、建投华科、申万宏源、时代伯乐、圆石投资、招商银行、江南基金、天辰元信、一久私募
时间	2026 年 10 月 16 日星期五上午 10：00
地点	深圳市龙图光罩股份有限公司会议室（三）
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书兼财务总监：邓少华 2、证券事务代表：李建东
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况： 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于 2010 年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 自 2024 年 8 月公司完成科创板挂牌上市以来，公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺能力从 130nm 逐步提升至 65/55nm，并已完成 40nm 工艺节点的生产设备布局，产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。 公司于 2022 年 8 月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域持续加大研发投入，稳步推进高端制程的国产化配套，目标成为国内一流、国际领先的半导体掩模版标杆企业。 二、投资者互动交流： 1、公司向特定对象发行股票目前进展如何？预计何时启动发行？募集资金的主要用途是什么？

	回复：公司本次向特定对象发行 A 股股票的核心目的，是为 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设提供资金支持，拟募集资金不超过 14.60 亿元，项目总投资约 19.54 亿元，具体包括更高制程掩模版产线建设、关键设备采购、工艺技术研发以及配套团队建设。目前，本次发行已履行董事会、股东会审议程序，公司已按期完成上海证券交易所审核问询函及审核中心意见落实函的回复，已于 2026 年 8 月 27 日取得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2026〕2242 号），并于 2026 年 9 月完成本次发行募集说明书披露。目前公司正处于发行准备阶段，将根据监管要求和市场情况择机启动发行工作，同时综合运用经营积累、银行融资等多种方式，确保资金链安全与项目顺利实施。 2、公司光罩产品的量产、送样验证情况如何？客户导入认证周期一般是多长？ 回复：目前，公司 130nm 及以上制程产品在深圳工厂保持规模化量产，深圳工厂产能利用率维持在较高水平；珠海工厂一期 90nm 产品已实现稳定量产；65/55nm 产品送样验证正常推进中，已在多家客户开展验证；40-28nm 高阶制程产线项目规划与建设同步推进。需要说明的是，掩模版客户导入验证周期平均约 12-18 个月，越高端节点周期越长，完整流程一般需经过设备规格匹配与工艺基线对齐、标准验证片制版流片、量产线同步陪跑验证，最终通过 WAT/CP/FT 全流程测试验证后，方可正式量产放行（Release）。由于掩模版是晶圆制造环节的核心图形母版，一旦出现图形尺寸偏差、套刻偏移或隐性缺陷，将直接造成整批次晶圆报废，因此客户对掩模版的资格认证极为审慎；而认证通过后客户切换成本极高，合作黏性普遍较强。 3、公司当前产能利用率情况及未来的产能分布如何？ 回复：当前产能格局呈“深圳基地高产、珠海基地爬坡”特点，针对行业结构性增长需求，公司正加速珠海产能释放、重点提升高端产品供给能力。未来产能呈梯度布局、深度协同：深圳工厂聚焦 130nm 及以上成熟制程，承担稳定基本盘与现金流的角色；现有珠海一期聚焦 55nm-130nm 中高端制程，是当前产能爬坡与技术升级核心阵地；本次定增募投的珠海二期聚焦 40nm-28nm 高端制程，完全达产后预计将新增年产能 15,000 片，将有效填补公司高端产能。 4、珠海工厂一期当前经营及产能爬坡情况如何，
--	--

	预计何时实现盈利？ 回复：珠海工厂一期聚焦 130nm-65/55nm 节点，以电子束光刻、PSM（相移掩模）技术为核心，90nmPSM 产品已实现量产，65/55nm 等高阶产品送样验证正常推进；截至目前珠海工厂已通过多家头部客户审核认证，部分客户已实现小批量订单交付，为承接高端订单、推动收入增长奠定基础。当前珠海工厂处于产能爬坡关键期，厂房及高端设备折旧较高、规模效应尚未充分释放，当期仍处于亏损状态。随着产能利用率、良率提升及高端产品放量，公司正全力推动珠海工厂尽快实现产能释放与盈利改善。 5、公司 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目（珠海二期）进展如何？ 回复：公司 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目由全资子公司珠海龙图实施，项目主体厂房已于 2025 年 9 月顺利封顶，目前正在有序推进厂房竣工验收、净化装修及设备选型采购等工作，项目环评已于 2026 年 4 月取得珠海市生态环境局批复。预计未来项目达产后，将新增 40nm-28nm 制程半导体掩模版年产能 15,000 片，产品主要面向高端模拟 IC、MCU 等应用场景，填补公司高端制程产能空白，并配套建设 KrF-PSM、ArF-PSM 等高端光罩产品能力。公司将结合募集资金到位情况，有序推进设备采购、安装调试及产线建设工作，并根据监管要求及时履行信息披露义务。 6、公司目前高端客户拓展及认证进展如何？客户结构有何变化？ 回复：客户方面，公司实施差异化市场策略：深圳工厂以深耕存量客户、稳定市场份额为核心，珠海工厂以拓展高端客户、加速认证突破为重点。珠海工厂持续完善生产与品质管理体系，2026 年上半年顺利通过华虹宏力、积塔半导体、粤芯半导体、三安光电、株洲中车等多家客户审核认证，部分客户已实现小批量订单交付。公司核心客户覆盖国内主要晶圆代工厂、IDM 厂商，以及先进封装、硅光及光通信、第三代半导体领域企业，客户结构与产品结构持续向高端制程升级，为公司长期增长奠定坚实基础。 7、公司核心原材料供应与设备使用的国产化进展如何？ 回复：公司核心原材料石英基板、光学膜目前高端仍主要依赖进口，这与半导体制造领域普遍现状一致，公司已将其列为重点管控的风险因素。目前正推进建立
--	--

	国产供应商验证体系，在国产基板能持续满足工艺稳定性与良率要求的前提下积极稳妥推进验证与导入；同时推进供应链多元化，评估引入更多合格供应商，并适当增加通用材料库存备货，降低原材料供应风险。设备方面，高端光刻/刻蚀/检测设备等仍以进口为主，公司将持续跟踪核心设备国产化进程，在保障性能与良率前提下支持国产设备验证导入。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 16 日星期五